製品規格/Product Spe	cification	1		Prepared		ecked	Approved	Esta	No. 1/2 blished	
品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ			by		by	by		Ву		
ि裡名/Type Number ENJI23W8FR2 公下統一品番/Matsushita Unified Parts Number ∶LNJ123W8PRZ			A.Nakano	T.T	abata	K.Furuno	X.7.	Turnho		
種別/Type	グリーン	////////////////////////////////////								
用途/Application		示用/Indica			,					
材質/Material	GaP (G	Green), Ga	AIAs (Red)						
外形/Out line	附図/At	tached		·						
			注 1)(Note	1) (注 2)(Note2)						
絶対最大定格	P	-	I _{FP}	I _{FDC}	V	R	Topr	т	Tstg	
Absolute Maximum Ratings	(G)		(G) (R)	(G) (R	(G)		00 .05	40		
Ratings	60 m\		60 60 mA	20 20 mA	4 V	3	-30 ~ +85 ℃		∽ +100 ℃	
試験条件/Condition		°C±3 °C	117.		v		0			
	」 電気的・光	化学的特性	/Electrical·	Optical Characteris	tics (1	「a=25 ℃:	±3 °C)			
項目		略号	発光色		,		Lin	nit		
Item		Symbol	Color	Measuring Conc	lition	Тур.	Min.	Max.	Unit	
順方向電圧降下		V _F	Green	I _F =10 mA DC		2.03	—	2.60	v	
Forward Voltage		VF	Red	I _F =10 mA DC		1.72	-	2.50	v	
逆方向漏洩電流			Green	V _R =4 V		_	—	10	μA	
Reverse Leakage Current		I _R	Red	V _R =3 V		-	—	100	μΛ	
光度(軸上) (注 3)	(Note3)	Ιo	Green	I _F =10 mA DC		5.0	1.8	—	mcd	
Luminous Intensity		10	Red	I _F =10 mA DC		4.0	1.5	—	mea	
ピーク発光波長		λp	Green	I _F =10 mA DC		565		—	nm	
Peak Emission Wavel	ength	лр	Red	I _F =10 mA DC		655	—	—		
スペクトル半値幅		⊿λ	Green	I _F =10 mA DC		30		-	nm	
Spectral Line Half Wic	dth		Red	I _F =10 mA DC		20	—	—		
ましては、お問 (Note1)・The condition Please contac I _F : less than D I _{FP} : less than p	下および/ い合わせの of I _{FP} is ct us for fi C =1 mA pulse wid	ペルス印加I のほどお願 duty 10 % urther info th =1 ms,	時間 pulse iい申しあげ ,pulse wid rmation re duty=10 %	th 1 ms garding special ope	rating c	onditions	such as			
(注 2) ·グリーン, レッド (Note2) ·When 2 light								ください。		
(注 3)(Note3) ·光度(軋 (注 4)(Note4) ·回路設	-					iminous ir	ntensity is ±	:20 %.		
(A)) •	NA N	••	(B) ~		A A A A	••			
	us nonuni			ラツキが懸念されます LEDs could be four				cs of eac	h	
		2008-04-2	21							



松下統一品畨/Ma	atsushita Unified Parts Number	
	:LNJ123W8PRZ	

製品規格/Product Specification

品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ

 2004-11-02
 2008-04-21

 Established
 Revised

Panasonic Semiconductor Opto Devices Co., Ltd.



						Sheet No.	4/2
製品規格/Produc	ct Specification						
	mber:LNJ123W8Pf atsushita Unified P :LNJ123W8P	arts Number					
本仕様 This sp	I/Scope of Applicati は SV2 色タイプチッ ecification is applie d to your company.	プ LED シリース d to "LNJ123"				series	
	生/Ratings and Cha 品規格による。/Refe		ned product sta	andards.(P1	~ 3/20)		
	ckage Outline 形図による。/Refer t	o the attached	d drawing of ov	verview. (P6/	20)		
上記包 Howeve	装仕様による。/Refe 装単位に満たない場	合、また明らか the number of	いに端数を生じる f products doe	かいいいい かいしん あんしん あんし うちょう かんしん あんし あんし あんし あんし うちょう あんし うちょう しんしん しんしょう しんしん しんしょう かいしん あんし しんしょう かいしん あんし かいしん しんしょう かいしん しんしょう しんしゅう かいしん ひんしゅう しんしゅう かいしんしゅう しんしゅう ひんしゅう しんしゅう ひんしゅう しんしゅう いんしゅう しんしゅう しん しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しん しゅう しん しゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しん しゅう しん しゅう しん しゅう しん しゅう しん しゅう しょ しん しょ	とする場合はその ne packing spe	cification or delivery	
各包装	ached Packing Spe 単位毎に品種名、数 t number, quantity,	量、製造密番る			dividual packa	ges.	
密番判	<u>読/How to read Dat</u>	<u>e Code</u>					
	参考/Reference)	84 ⇒ 200 <u>8</u>	年	2008			
	1 月 January 1	2 月 February 2		10 月 October O (<u>Q</u> ct)	Ν	D	
	ッキングケースのみ ite code only on the			ined.			
クラック Those	:/Appearance Inspe 、かけ、きず、ボイド、そ defects such as cra teristics should be u	その他、電気・光 icks, breakage	e, scar sand vo				
7. その他/O 7.1 使り		on use		lling instructi	ions.(P7~10/2	20)	
1)回 Ple 2)回 De the	計上の注意/Notes o 路には電流制御抵抗 ease design to com 路の ON/OFF 時に顧 esign to avoid apply e circuit.	を接続し、定格 hect the curre 瞬間的に逆電圧 ing an instant	nt control resis E(過電流)がか reverse voltaç	tor in the cir からないように ge (reverse c	cuit and opera こ設計してくださ	い。	
Ple 4)以 Av	ターン寸法、はんだ厚 ease use after verif 下に示すような環境 ⁻ oid using under en ・塵埃や腐食性ガス(ying the patte 下でのご使用を vironments as	rn size, solder お避けください。 shown in the f	thickness et	C,.		
	A place where du ・製品(LED)が結露す A place where dr	ist or corrosiv ける場所	e gas generate		D).		
2004-11-02	2 200	8-04-21					
Establishe	d Re	evised	1				
							_

			Sheet No. 5/20
製品規格/Product Specif	fication		
品種名/Type Number:LN 松下統一品番/Matsushita :L			
製品(LED) About plac)が加熱されることがないよう cement, design the circuit s	な抵抗器などの発熱体との隣接か な回路設計を行ってください。 so that the product(LED) may r t or too high density of parts.	
Mount the		「直角に実装し、製品へのストレス e longitudinal direction of the PV	
We recomm ・(B)の方法で ないことを確 If the LED n	ぎのご使用については、基板の ፤認のうえ、ご使用ください。 must be placed on the prin	n the printed wiring board as sh の反りが発生する可能性が有りま nted wiring board as shown in d	Eすので、LED の信頼性に問題の
	(LED arrangement on	printed wiring board)]
	(A)	(B)	
LED は、光 Since epox not gained 7.4 疑義につい	xy resin which is superior i d. いて/Doubt	樹脂のため、UL 規格は未取得で in optical characteristics is ado うの協議により決定するものといた	pted for the LED, UL standard is
		cations, it should be determined	
実使用上で Although it	での寿命、その他の品質につ it is ensured that products	、保証された品質のものを納入しる Dきましては貴社にて十分ご検討く satisfying every item in this spe stallation, life on practical use a	ください。 ecification are delivered, please
7.6 品種名表示	ਨੋ/Product name indication	1	
例/Examp	ple) <u>LNJ123W8P</u> <u>RZ</u>	<u>Z</u>	
	L	テーピング仕様/Tapein	ng specifications
		ーーーー チップ LED 品番/Chip	LED product No.
2004-11-02	2008-04-21		
Established	Revised		



製品規格/Product Specification 取扱い上の注意事項/Handling Instructions 品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number	
:LNJ123W8PRZ	

[保管/Storage]

 製品の搬送中および保管中の吸湿を避けるため、シリカゲル入りのアルミラミネート袋による防湿包装を行って おります。吸湿が進行するとシリカゲル内のインジケータが変色(青色からピンクに変色)しますのでご注意願います。 アルミラミネート袋開封後は製品の吸湿が急速に進行し、最悪の場合リフロー時の熱ストレスで特性不良が発生 いたします。ご使用に際しては1袋毎に開封し、速やかにリフローを完了されるように徹底してください。 In order to avoid absorption of moisture during conveyance and storage of products, we are applying moisture-proof packaging by means of aluminum-laminated bags containing silica gel. Then, when absorption of moisture proceeds, the color of indicators in the silica gel changes from blue to pink, to which must be paid much attention.

After the aluminum-laminated bag is opened, absorption of moisture of the products proceeds quickly, which is likely to cause characteristic defects due to thermal stress generated during the re-flowing process in the worst case.

Therefore when these products are used, be sure to open the bags one by one to complete re-flowing quickly.

[製品の保管条件および保管期間/Conditions and Terms of Storage of Products]

1) 製品の保管は、製品の状態より下記の条件でお願いいたします。

Please store products according to the following product conditions depending on the conditions of the products.

製品状態	保管条件/Conditions of Storage				
表面次感 Conditions of Product	周囲温度	湿度	期間		
	Ambient Temperature	Temperature humidity	Term		
アルミラミネート袋未開封 When aluminum-laminated bag is not opened yet	10 °C ~ 30 °C	70 %以下 70 % or under	1 年間以内 Within one year after aluminum-laminated bag has been opened		
アルミラミネート袋開封後 When aluminum-laminated bag is opened	10 °C ~ 30 °C	70 %以下 70 % or under	7 日間以内 Within 7 days		
1 回目リフロー後、2 回目まで Up to the second time after the first reflowing	10 °C ~ 30 °C	70 %以下 70 % or under	7 日間以内 Within 7 days		

上記の保管条件を超えた場合(同封シリカゲルのインジケータ変色なども含む)は使用前にベーキング処理にて 除湿を行ってください。

If the above-mentioned treatment was not made (including a case of discoloration of the silica gel indicator in the bag or similar), remove moisture by means of baking treatment or the like before use.

<推奨ベーキング条件/Recommended Baking Conditions>

リール状態 (アルミラミネート袋から取り出して) 温度:60 °C,時間:12 h 以上 ~ 24 h 以内 <u>(但し、ベーキング処理は 1 回までとします)</u> In a reel condition (as taken out of the aluminum-laminate bag) Temperature:60 °C. Time: More than 12 h and up to 24 h. (However, the baking treatment is limited to one time only.)

2004-11-02	2008-04-21
Established	Revised

製品規格/Product Specification 取扱い上の注意事項/Handling Instructions 品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number :LNJ123W8PRZ

[洗浄/Washing]

- 1) 原則として洗浄は行なわないでください。/Do not wash the products in principle.
- 2) セット上の理由で、洗浄が必要となった場合は、製品実装後(リフロー後)で行なうものとし、必ず下記の条件で お願いいたします。

If washing is required by a reason of the set, be sure to make it after the products are mounted (after reflowing) according to the following conditions.

・洗浄溶剤についてはアルコール系を推奨いたします。なお、塩素系溶剤は端子の腐敗や樹脂を溶解させたり、
 製品の劣化の原因となりますので使用しないでください。

As for the washing agent, an alcoholic agent is recommended. Do not use a chlorine-system agent because it corrodes terminals and dissolves resin to cause deterioration of the products.

・超音波洗浄については、セットの実装基板毎に影響が異なる(共振など)と考えらますので、実際のご使用に あたっては、十分確認されたうえで導入いただけますようお願いいたします。 As for ultrasonic cleaning, it may differently affect each of the mounting board, such as resonance. Sufficient checks on the ultrasonic cleaning is required for actual use.

・ブラッシングは発光面を傷つける場合がありますので避けるようにしてください。 Avoid the use of brushing because it sometime damages light-emitting surfaces.

[リフローはんだについて/The reflow soldering]

- 1) 1 回目リフローについて/The first time reflow soldering
 - 開封後長時間放置しますと諸特性への影響が懸念されますので、スペックの保管期間と条件を遵守いただき (7日以内)、下記条件でリフローはんだ処理を実施してください。

The products exposed to moisture more than 7 days after the package opening may have negative influence on characteristics. Please observe the storage term and the condition in this specification strictly and proceed the reflow soldering in the following conditions.



製品規格/Product Specification	
取扱い上の注意事項/Handling Instructions	
品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ	
松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number	
: LNJ123W8PRZ	

[手はんだについて/Manual soldering Iron]

- コテ先温度 350 ℃、3 秒以内を基本とし、コテ先温度がそれ以上となる時は時間を短縮するようにしてください。 (目安;+10 ℃あたり、1 秒間短縮)
 Basically keep the temperature on the edge of iron at 350 ℃ and apply within 3 s.
 If the temperature is higher than the condition above, apply in a shorter time (1 s per 10 ℃).
- 2) はんだごては温度コントロール付きのものを使用される事を推奨いたします。 The iron equipped with temperature control circuit should be used.
- はんだ付け時、パッケージとリード端子部に機械的ストレスが加わらないようにご配慮ください。
 特に、コテ先をパッケージとリード端子部に接触させないでください。過度ストレスが加わると素子の破壊が発生 する可能性があります。
 Do not give a stress to lead or resin on soldering. Especially do not let iron contact with them.
- A LED chip will be damaged and broken by extreme stress.4) はんだ付け直後に製品の取り付け修正、基板の反り修正を行った場合も同様です。
 - Do not also give a stress to the device and bend of PWBs adjusted right after manual soldering iron.
- 5) 修正に際し、一旦はんだ付けした LED を基板から取り外して、再使用することは避けてください。 The LED which was removed from PWBs should not be used again.

製品規格/Product Specification 取扱い上の注意事項/Handling Instructions 品種名/Type Number: LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number	
:LNJ123W8PRZ	

[自動実装について/Automatic Mounting]

本製品は、マウンターによる自動実装が可能な部品ですが、製品の構造および性能上、次のような項目を十分留意のうえ、ご使用ください。

These products are available for automatic mounting machines.

However, concerning demand on structure and performance of these devices, you should pay attentions to the followings below.

1) 製品の帯電防止対策を実施していますが、作業環境が乾燥している場合は静電気が発生しやすくなり、

テーピング材に製品が付着し部品実装率を低下させることがあります。

安定してご使用いただくために、環境の湿度コントロールや除電対策を検討ください。 Though we've performed anti-static operation on these devices, static electricity can be frequently occurred in dry atmosphere and cause products to stick on the cover tapes. Please study to control humidity and to perform anti-static measure.

2) マウンターにより十分な実装率が確保できない場合、次のようなパラメーターをご検討ください。

If a successful mounting is not secured on your systems, you may study the following subjects.

吸着ノズル径 Inside diameter of tool	丸ノズルについては、製品吸着天面よりはみ出さない内径のものをお選びください。(例:1608 タイプ LED ⇒ 1005 用ノズル) Especially for a round shaped tool, please choose the one not sticking out from the LED's lens area. (Example : 1005 type tool is suitable for 1608 LED's.)
吸着ノズル形状 Shape of tool	特殊ノズルについては、製品が傾いたりする形状がありますので、吸着位置やサイズなどを検討してください。 For a particular tool ("asterisk" type etc.), which intends to incline due to its shape. Please study the location and the size of it.
ノズル位置 Height of tool	テープ走行面から高さをややマイナスめに設定してください。 Please set the height of the tool a little lower from top of the face of tape guide.
吸着位置 Position in absorption	製品形状によっては、吸着天面の狭いものがありますので、できるだけセンターを 狙って位置合わせをしてください。 Please adjust the absorb position as a center of device as possible.
実装時の振動 Vibration in mounting	実装時の振動を低減するよう、実装速度の最適化、テープ巻き取り時およびテー プ送り時のテンションの最適化などの対策をご検討ください。 To reduce the vibration on mounting, please discuss taking necessary measures against optimization of mounting speed and tensions in winding and feeding tapes.
ピン突上げ Pin push up system	エンボス底部にピンホール(ϕ 0.5 mm)があるものについてはピン位置に注意してく ださい。また、ピンホールのないものはピン突き上げに適していません。 Mind the pin position of the products prepared a pin-hole(by ϕ 0.5 mm) on the bottom of the embossed tape. "Pin push up system" is suitable only for products with a pin-hole but not for others.

[製品強度について/About product strength]

本製品は、発光素子封止材にエポキシ系樹脂を使用しています。チップ抵抗などのセラミック系面実装部品と異なり、 加熱時には樹脂強度が低下しますので、樹脂部などに直接強い衝撃を加えると剥離することがあります。 特に、はんだリフローやはんだコテ使用時の加熱工程での取り扱いにご注意ください。

また、実装後はプリント実装基板の取り扱い不注意、基板同士の重ね合わせ、マガジン収納時の無理な出し入れ、 あるいはハンドリング時の製品に直接衝撃が加わる場合、製品の破損が予想されますので、特に小型チップ LED についてはご注意ください。

In these products, we use epoxy resin for molding LED devices.

The resin is softened by heating and strength of resin becomes weak, different from those of other SMD's. So you should pay attention to keep products from shocking on resin side, especially during soldering process and using soldering irons.

And after soldering process, please avoid shocking directly on resin side, such as in the following cases, handling PCB's, piling them up and putting them in magazines. Especially small type chip LEDs should be carefully handled.

製品規格/Product Specification 信頼性保証基準/Reliability Assurance Criterion 故障判定基準/Failure Criterion 品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number :LNJ123W8PRZ

信頼性保証基準は、(MIL-STD-19500H LTPD:15%)です。 Reliability Assurance Criterion (MIL-STD-19500H LTPD 15%)

項目/Item	条件/Test Condition	結果 Result
連続動作寿命 Consecutive operating life test	I _{FDC} Max., Ta=25 °C, t=1 000 h	0/15
高温放置寿命 High temperature storage life test	Tstg Max., t=1 000 h	0/15
低温放置寿命 Low temperature storage life test	Tstg Min., t=1 000 h	0/15
高温高湿高湿放置寿命 High temperature humidity storage life test	Ta=60 °C, RH≧90 %, t=1 000 h	0/15
はんだ耐熱 Soldering heat test	温度/Temperature∶Ta=250 ℃, t=10 s Max., Max. 260 ℃ リフローはんだ/(Reflow soldering)	0/15
温度サイクル Temperature cycle test (gaseous phase)	温度/Temperature:【Tstg Min.~25 °C~Tstg Max.~25 °C】 時間/Time : (30 min 5 min 30 min 5 min) × 5 cycles	0/15
熱衝撃 Thermal shock test (liquid phase)	温度/Temperature∶【Tstg Max. ~ 0 ℃】 時間/Time : (5 min 5 min) × 5 cycles	0/15
落下 Fall test	h=75 cm, 楓板, 自然落下, 3 回 Maple wood h=75 cm, 3 times	0/15

故障判定基準/Failure Criterion

電気的特性/Electrical Characteristics					
項目/Item	略号 Symbol	試験条件 Test Condition	許容値/Limit	単位 Unit	
順方向電圧降下 Forward Voltage	V _F	製品規格の条件に同じ Same as the Product Standards	上限規格 × 1.2 Upper Limit × 1.2	V	
逆方向漏洩電流 Reverse Leakage Current	I _R	製品規格の条件に同じ Same as the Product Standards	上限規格 × 2.0 Upper Limit × 2.0	μA	
光度 Luminous Intensity	Ι _ο	製品規格の条件に同じ Same as the Product Standards	★下限規格×0.7 ★Lower Limit×0.7	mcd	

★動作寿命後の経時変化率は、初期値×0.5 以上の残存率を許容値とします。 The decreasing ratio of luminous intensity after the operating test should be greater than 50 % of initial intensity.

(注記/Notes)

内容的に別途要望がございましたら、お問い合わせください。

If you have any special requirements, please inquire of us.

2004-11-02	2008-04-21
Established	Revised



Panasonic Semiconductor Opto Devices Co., Ltd.



Panasonic Semiconductor Opto Devices Co., Ltd.

Sheet No.14/20

製品規格/Product Specification テーピング仕様/Taping Specification 品種名/Type Number: LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number :LNJ123W8PRZ







製品規格/Product Specification	
品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ 松下統一品番/Matsushita Unified Parts Number :LNJ123W8PRZ	
【光素子に対する熱ストレス/Thermal Stress To Optical E 光素子(LED、フォトダイオード、フォト IC、フォトセン+	Device】 ナ、フォトカプラ)のパッケージ樹脂は、光透過率を重要視する

ため、その中に決 度が低く、最大代 中の光素子の熱 Since the pack attach importar For this reason LSI's and so or Unless it is des conditions into	和剤を入れることが制約 保存温度近傍にあります。 なトレスにより出力低下や age resin of optical devid nce to light transmissivity , it has a lower thermal o n and is in the vicinity of igned under the operatir	フォトセンサ、フォトカプラ)のパッケージ樹脂は、光透過率を重要視する されています。このため、IC,LSI などのパッケージ樹脂に比べ熱変形温 動作電流や環境条件を加味した使用条件で設計されていないと、動作 b断線など、素子を破壊させる原因となります。 ces (LED's, photodiodes, photo ICs, Photosensors, photocouplers) y, it is restricted to include additives in them. deformation temperature, compared with the package resin for ICs, the maximum storage temperature. ng conditions taking into an operating current and ambient vices may be destroyed lower light output and disconnection due to optical devices.
【本書に記載の技術	青報および半導体のご使用	用にあたってのお願いと注意事項】
【Request for your s		cautions in using the technical
	information and	semiconductors described in this book.
	載の製品および技術で、「タ す時は、日本政府の許可	外国為替および外国貿易法」に該当するものを輸出する時、または、 が必要です。
An export pe	rmit needs to be obtaine	d from the competent authorities of the Japanese Government if
		lescribed in this book and controlled under the "Foreign Exchange orted or taken out of Japan.
		特性および応用回路などを示したものであり、弊社もしくは第三者の Eまたは実施権の許諾を意味するものではありません。
The technica	I information described i	in this book is limited to showing representative characteristics and
		ucts. It neither warrants non-infringement of intellectual property r company or a third party, nor grants any license.
		かかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありません。
	able for the infringement chnologies as described	t of rights owned by a third party arising out of the use of the l in this book.
	載されている製品は、標準 ことを意図しております。	用途ーー般電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)
用途一特定用	途(航空・宇宙用・交通機	な障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある 器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置など)にご使用をお考えのお
各様わよび、 います。	自在か息凶した標準用述は	以外にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業窓口までご相談願
The products electronic eq	uipment (such as office	are intended to be used for standard applications or general equipment, communications equipment, measuring instruments
	ld appliances).	r information on the following applications:
		airplanes, aerospace, automobiles, traffic control equipment,
combusti	on equipment, life suppo	ort systems and safety devices) in which exceptional quality
	bility are required, or if th he human body.	ne failure or malfunction of the products may directly jeopardize life
		andard applications intended.
2004-11-02	2008-04-21	
-	_	

Established

Revised

製品規格/Product Spec	ification			
品種名/Type Number:L	N 1123W8PR7			
	ita Unified Parts Numbe	er		
:	LNJ123W8PRZ			
ご了承ください	0		改良などのために予告なく変更する場合があり	
したかって、最適		使用に除し	ましては、事前に最新の製品規格書または仕様	^{表書} をお求め
The products modification a therefore, ask	and product specification and/or improvement. At the for the most up-to-date	the final s e.	bed in this book are subject to change with tage of your design, purchasing, or use of th at the latest specifications satisfy your requ	he products,
	ます。保証値を超えてご(団、放熱特性については保証範囲内でご使用し 場合、その後に発生した機器の欠陥については	
弊社製品の動	作が原因でご使用機器が	「人身事故	いて通常予測される故障発生率、故障モードを 、火災事故、社会的な損害などを生じさせない)対策を講じていただきますようお願いいたしま [、]	冗長設計、
When designi rating, the rar	ng your equipment, con age of operating powers	nply with t supply vol	he guaranteed values, in particular those of tage and heat radiation characteristics. which may arise later in your equipment.	
Even when th	e products are used wit	hin the gu	aranteed values, take into the consideration	n of
			sible to occur to semiconductor products. esign, arresting the spread of fire or prever	nting glitch
			injury, fire, social damages, for example, by	
			の仕様取り交わしの折り、取り決めた条件(保存	序期間、
When using p	amount of time let stand	dity-proof	packing is required, observe the conditions sealed items) agreed upon when specificati	
This book ma		oroduced	なしに、転載または複製することを固くお断りい whether wholly or partially, without the prior ., Ltd.	
9) その他/Other	S			
本仕様書に関	し疑問や変更の必要が生		は、両社で打ち合わせのうえ解決するものとしま pecification, mutual discussion will be made	
			₪質および特定臭素系難燃材は一切使用	
	(直接含有、工程で Not using the O		ておりません。 PBBOs in the LEDs.	
	Not using the O	,D,O and		
2004-11-02	2008-04-21			
Established	Revised			

品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ

松下統一是	品番/Matsushita Unified Parts Number
	:LNJ123W8PRZ

【保証/Guarantee】

信頼性試験結果または信頼性保証基準の項目および条件内での保証といたします。

なお、保証は納入品単体での保証であり、交換作業に伴う作業工賃、損害補償などの経費はご容赦願います。 また、次の場合には保証期間中でも有償とさせていただきます。

・取り扱いの不注意および誤った使用による故障。

·不当な修理や改善などによる場合の故障。

・天災などの不可抗力によって生じた故障。

疑義が発生した場合は原則として両者立会いのうえ、確認させていただき原因を明確にしたうえで処置対策させていただきます。

The warranty will be valid only within the reliability test results or the items and terms of the reliability assurance standard.

It is also limited to that of the delivered product itself and we are not responsible for the labor cost for replacement work, compensation for loss and the like.

The following cases are onerous since they are out of our guarantee even during the guarantee period:

- $\cdot \mbox{Troubles}$ resulting from careless handling or erroneous use.
- $\cdot \mbox{Troubles}$ resulting from unreasonable repair or improvement.
- •Troubles resulting from irresistible force such as natural disasters.

Should there be any doubt, we will verify it to clarify the cause in the presence of both parties in principle and take a proper action.

【その他/Others】

 1) 貴社との品質に関する取り決め事項は、本納入仕様書に記載されている事項が基本であり、受領以前に 交わされた取り決め事項のうち、本納入仕様書に記載されていない事項は全てその効力を失うものとします。 ただし、不備に際しては別途打ち合わせなどを行い、対応推進といたします。受領後、変更する必要が生じた 場合は文書により双方が合意に達した事項のみが有効となります。
 For matters on quality agreed between you and as those mentioned in these delivery specifications only are valid basically and matters decided between you and us before the receipt of these specifications become invalid unless they are mentioned in these specifications. But, if any inadequacy is present, we are ready for a discussion with you to settle the matter. In case any modification is required after the receipt of those specifications, only matters agreed by you and us are valid.

2) 特殊使用および疑問点に関しましては、事前連絡くださいます様お願いいたします。 For a special application or question, contact us before the fact and without delay.

- 本納入仕様書に記載してある事項については、保証された品質のものを納入いたしますが、実機組み込み、 実使用上での寿命、その他の品質につきましては貴社にて十分ご確認ください。
 Though we will deliver the products for which we guarantee the matters on quality mentioned in these specifications, please investigate on your side the incorporation into actual sets, duration under actual working conditions and other matters on quality of the products sufficiently.
 - 本納入仕様書発行後、2週間経っても返却なき場合は、受領されたものと判断いたしますので、ご了承願 います。

If these delivery specifications are not returned to us within two weeks after the issue, we regard them as received ,which please understand.

- 5) 納入仕様書内容の変更については、事前協議のうえ、実施いたします。 The specifications will be changed after prior discussion.
- 6) 本製品は RoHS フリー対応製品です。 This product is RoHS-free supported.

2004-11-02	2008-04-21
Established	Revised

改訂履歴 Revision History

品種名/Type Number:LNJ123W8PRZ

改訂日 Revised Date	改訂項 Page	改訂内容 Contents of revision	備考 Notes
2004-11-02		·新規制定/Novel enactment	
2006-08-07	P1~20/20	·社名呼称変更/Company name change.	
2008-04-21	P6/20	·外形図 基板変更/Outline Substrate change	